

性能特点：

- 频带：1~8GHz
- 噪声系数：1.4dB
- 增益：23dB
- 输入/输出回波损耗：>8.5dB/>8dB
- 输出 P1dB：16dBm
- 单电源供电：+5V@73mA
- 芯片尺寸：2.4mm×1.2mm×0.1mm

产品简介：

HH-LN0108 是一种 GaAs MMIC 宽带低噪声放大器芯片，其频率范围覆盖 1~8GHz，整个带内噪声系数典型值为 1.4dB。HH-LN0108 采用+5V 供电。

电参数： ($T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_d=+5\text{V}$)

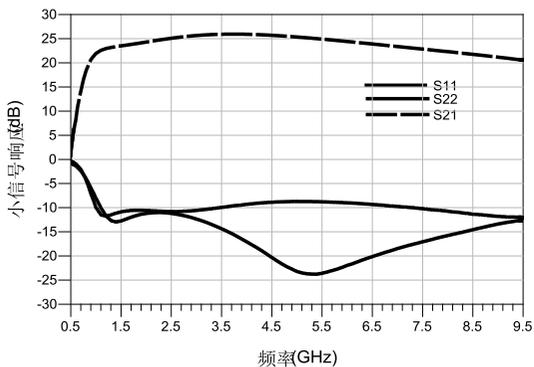
指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围		1~8		GHz
噪声系数	1.1	1.4	2.1	dB
增益	22	23	26	dB
输入回波损耗	8.5	-	-	dB
输出回波损耗	8	-	-	dB

使用限制参数： (超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。)

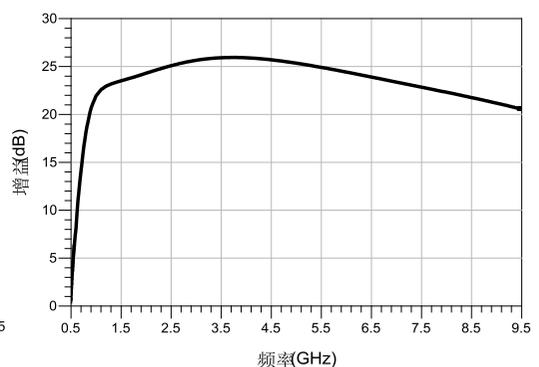
输入功率	+18dBm
控制电压	+5V
存储温度	-65°C~+150°C
使用温度	-55°C~+125°C

典型曲线：

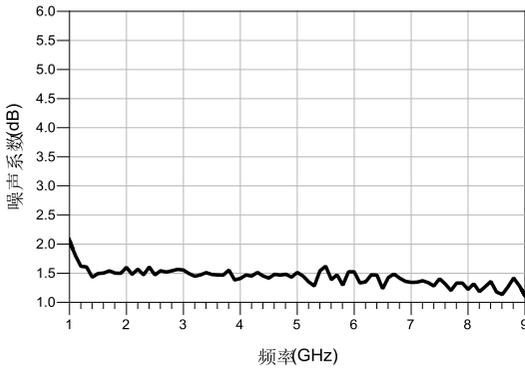
小信号响应 (25°C)



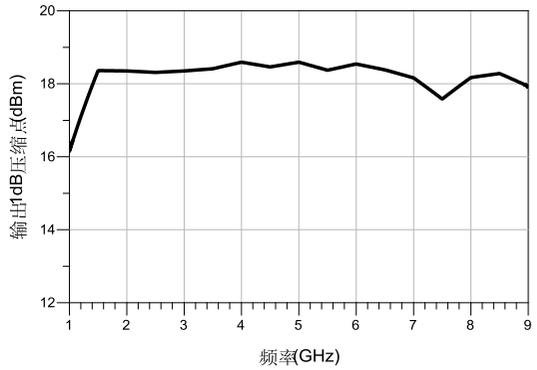
增益 (25°C)



噪声系数 (25°C)



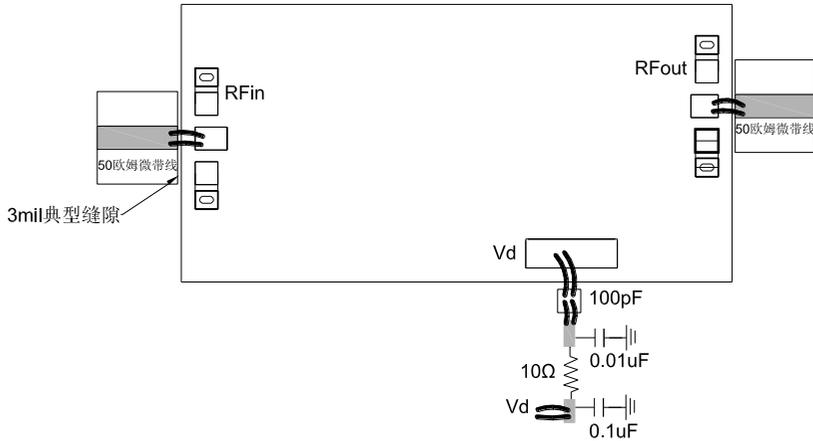
输出 1dB 压缩点 (25°C)



尺寸图 : (单位 mm)



建议装配图 :



使用说明：

注意事项：输入输出有隔直电容

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。

键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。